

1 特許庁が異議2001-73357号事件について平成15年5月
した決定中「特許第3176580号の請求項1, 2に係る特許を取り消
の部分を取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由

1 原告
(1) 主文 1 項と同旨
(2) 訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告
(1) 原告の請求を棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。

1 特許庁における手続の経緯
原告は、発明の名称を「電子部品の実装方法及び実装装置」とする特許（特
第3176580号、平成10年4月9日出願、平成13年4月6日設定登録。
下「本件特許」という。請求項の数は7である。以下、請求項1の発明を「本件
明1」、請求項2の発明を「本件発明2」といい、まとめて「本件発明」とい
。）の特許権者である。

2 決定の理由

3 訂正審決の確定

4 本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲（甲第2号証・特許公報記載のもの）

超音波振動発生装置と、ホーンと、コレットツールと、基板導体加熱装置と、制御系装置と、からなり、フリップチップボンディング方式の超音波併用熱圧着接続を行う電子部品の実装装置において

電子部品の電極または基板導体の電極に設けたバンプの沈み込み量をモ二
タリングする高さを測定したことを特徴とする装置は前記
前記高さを測定したことを特徴とする装置は前記装置の良否判定

(2) 請求項 2

請求項 1 記載の電子部品の実装装置にて電子部品を基板導体に対して降下させ、電子部品の電極または基板導体の電極に設けたバンプが対向する相手側の電極と接した時点から所定加重を印加し、次に所定加重と超音波振動を所定時間印加することによるバンプの沈み込み量を高さ測定装置にてモニタリングし、前記超音波振動印加時のバンプの沈み込み量が所望の範囲内であるか否かによってフリップチップボンディング方式の超音波併用熱圧着接続による接合の良否判定を行うことを特徴とする電子部品の実装方法。

5 本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲

(1) 請求項 1

超音波振動発生装置と、ホーンと、コレットツールと、基板導体加熱装置と、制御系装置と、からなり、フリップチップボンディング方式の超音波併用熱圧着拡散接合を行う電子部品の実装装置において、

電子部品の電極または基板導体の電極に設けたA_uバンプの沈み込み量をモニタリングする高さ測定装置を前記制御系装置と連結して備え、前記制御系装置は前記高さ測定装置で得たA_uバンプの加重と超音波の印加時における沈み込み量が所望の範囲内か否かで接合の良否判定を行いつつ実装することを特徴とする電子部品の実装装置。

(2) 請求項 2

請求項 1 記載の電子部品の実装装置にて電子部品を基板導体に対して降下させ、電子部品の電極または基板導体の電極に設けたA_uバンプが対向する相手側の電極と接した時点から所定加重を印加し、次に所定加重と超音波振動を所定時間印加することによるA_uバンプの沈み込み量を高さ測定装置にてモニタリングし、前記超音波振動印加時のA_uバンプの沈み込み量が所望の範囲内であるか否かによってフリップチップボンディング方式の超音波併用熱圧着拡散接合による接合の良否判定を行うことを特徴とする電子部品の実装方法。

(判決注・下線部が訂正部分である。)

第 3 当裁判所の判断

上記当事者間に争いのない事実の下では、本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲請求項 1 及び 2 について、特許法 29 条 2 項に違反して登録された特許であることを理由に、その特許を取り消した決定の取消しを求める訴訟の係属中に、上記各請求項についての特許請求の範囲の減縮を含む訂正の審判の請求がなされ、特許庁は、これを認める審決（本件訂正審決）をし、これが確定したといえることができる。

決定は、これにより、結果として、上記各請求項のいずれについても、判断の対象となるべき発明を特定すべき特許請求の範囲の文言の認定を誤ったことになる。この誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって、決定は、上記各請求項のいずれについても取消しを免れない。

以上によれば、本訴請求は理由がある。そこで、これを認容し、訴訟費用の負担については、原告に負担させるのを相当と認め、行政事件訴訟法 7 条、民事訴訟法 62 条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第 6 民事部

裁判長裁判官 山 下 和 明

裁判官 設 楽 隆 一

裁判官 高 瀬 順 久